(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2008 年2 月7 日 (07.02.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/015759 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 7/00 (2006.01) *H01L 25/04* (2006.01)
C09J 179/08 (2006.01) *H01L 25/18* (2006.01)
H01L 21/52 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/315493

(22) 国際出願日: 2006 年8 月4 日 (04.08.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 増子 崇 (MASUKO, Takashi). 杉浦 実 (SUGIURA, Minoru). 加藤木 茂樹 (KATOGI, Shigeki). 湯佐 正己 (YUSA, Masami).

(74) 代理人: 三好 秀和，外(MIYOSHI, Hidekazu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号 虎ノ門琴平タワー Tokyo (JP).

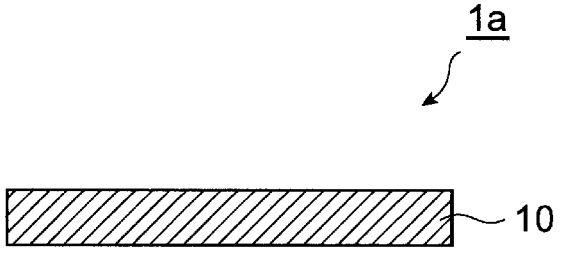
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(54) **Title:** FILM ADHESIVE, ADHESIVE SHEET, AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING THE SAME

(54) 発明の名称: フィルム状接着剤、接着シート及びこれを使用した半導体装置



(57) **Abstract:** This invention provides a film adhesive that can simultaneously satisfy process characteristics and reflow resistance requirements. The film adhesive is used for bonding a semiconductor element to an adherend and comprises an adhesive layer containing at least one resin selected from polyurethane imide resins, polyurethane amide imide resins, and polyurethane imide-polyurethane amide imide resins.

(57) 要約: 本発明は、プロセス特性、及び耐リフロー性を両立できるフィルム状接着剤を提供することを目的とする。本発明のフィルム状接着剤は、半導体素子を被着体に接着するために用いられるフィルム状接着剤であって、ポリウレタンイミド樹脂、ポリウレタンアミドイミド樹脂、及びポリウレタンイミド－ポリウレタンアミドイミド樹脂から選ばれる少なくとも１種の樹脂を含有する接着剤層を備える。

WO 2008/015759 A1